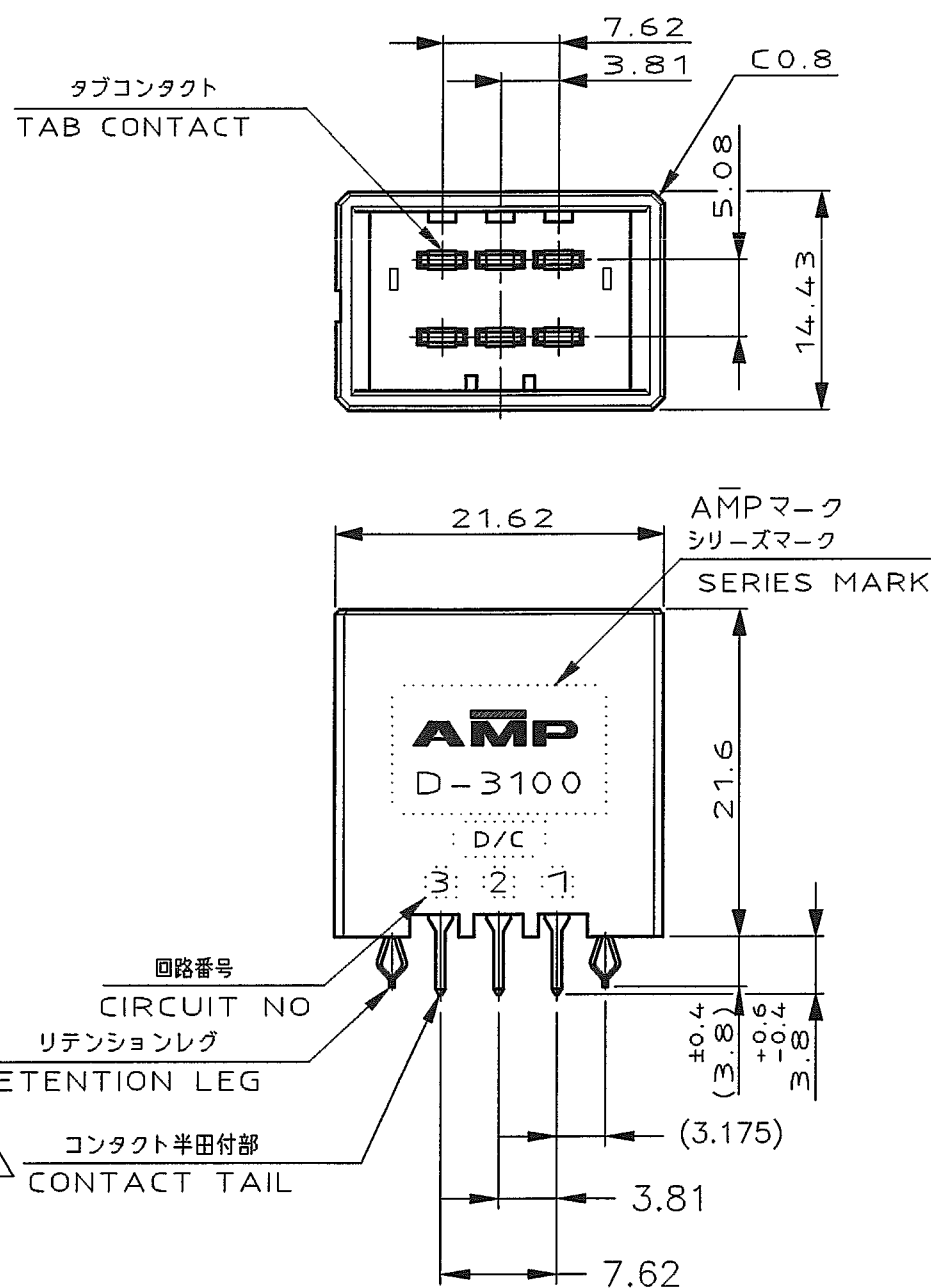


NUMBER
178323

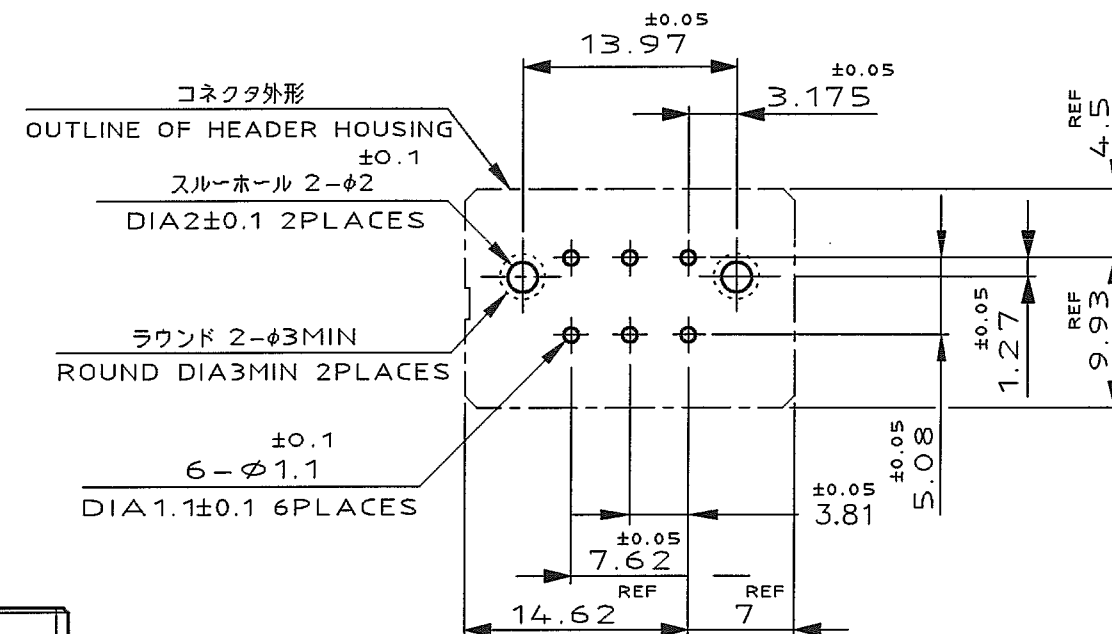
METRIC

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST



△6	△4	178323-5
△6	△3	178323-3
△6	△2	178323-2
(FINISH)		製品番号 (PART NO.)



推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚: 1.6±0.1
(非累積公差)
(コネクタ搭載面)

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS: 1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)

NOTES

- MATERIAL: HOUSING: GLASS FILLED THERMO PLASTIC, POLYESTER
CONTACT: COPPER ALLOY
RETENTION LEG: COPPER ALLOY
- △2. FINISH (CONTACT AREA): 0.38μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △3. FINISH (CONTACT AREA): 0.76μm MIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
- △4. FINISH (CONTACT AREA): 2.0 μm MIN TIN PLATED OVER NICKEL
- △5. FINISH (RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL
- △6. FINISH (RETENTION LEG): TIN PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

- 材料: ハウジング: ガラス入り熱可塑性
ポリエスチル樹脂
コンタクト: 銅合金
リテンションレグ: 銅合金
- △2. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.38μm MIN金めっき
- △3. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 0.76μm MIN金めっき
- △4. めっき: コンタクト: 全面Ni下地
接触部: 2.0 μm MINスズめっき
- △5. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上に半田めっき
- △6. めっき: リテンションレグとコンタクト半田付部
ニッケル下地の上にスズめっき

D1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE

				 TE Connectivity				
WIRE RANGE		INSULATION DIA		NAME				
mm ² (AWG -)		- mmφ		DOUBLE ROW (D-3100)				
MATERIAL		FINISH		DYNAMIC CONN. 6POS. VERTICAL HDR. ASS'Y				
SEE NOTE 注記参照		SEE NOTE 注記参照						
DR. 15 FEB '91 N. Matsubara		DE. 15 FEB '91 N. Matsubara		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		SIZE	LOC	NUMBER
CHK. 21 MAY '91 T. Obara		APP. 21-MAY-'91 S. MANABE		10mm ±0.3 10mm 30mm ±0.4 30mm 100mm ±0.5 角 度 ±3°		A3	J	C-178323
						SCALE	REV.	SHEET
						2-1	D1	1 OF 1